

RMA201 AU80-SN20 焊膏

特性

- ▶ 良好的润湿性
- ▶ 扩展的清洁窗口
- ▶ 卓越的抗坍塌性能
- ▶ 粘附时间 6 小时
- ▶ 可用加有皂化剂的水清洗
- ▶ 宽广的工艺窗口

描述

RMA201 活性适中，是一款 QQS571-E, QPL 认可的纯橡胶树脂焊膏。该产品设计专用于比正常温度高的回流焊工艺，焊后残留经过测试后仍可确保高绝缘阻抗，并且可能残留在 PCB 板上且不降级。松香活性可充分润湿基板上的大部分金属表面。RMA201 宽广的工艺窗口可根据环境和工艺应用作出多样的变化。本产品在持续生产作业中表现良好，优秀的抗塌落性、高粘附力和低焊后残留。

标准锡膏组成

应用方式	IPC 锡粉尺寸	金属含量
标准钢网印刷	3	90%
细间距钢网印刷	5	89.5%
超细间距钢网印刷	5	89%
针筒点涂	3	85.5%

回流曲线

升温斜率 1.5-2°C/Sec Max	升温至 170°C (338°F)	170°C-230°C (302°F-446°F) 之间 时间	到峰值温度 300°C-320°C (572°F-608°F)	280°C (530°F) 温度 以上	冷却速度≤ 4 °C / SEC	室温到峰值温度 的时间
Initial Profile	≤ 75 Sec	45-100 Sec	45-75 Sec	30-60 Sec	45 ± 15 Sec	3.5-4.0 Min

印刷设置

推荐初始印刷机设置-根据 PCB 和焊盘设计提供	
参数	推荐初始设定
刮刀压力	1 – 1.5 磅/英寸每刀片
刮刀速度	.5 – 6 英寸/秒
接触距离	接触 0.00 mm
PCB 分离距离	0.030 - .050"
PCB 分离速度	中等

锡膏应用

在丝网上施加足够的焊膏，以使其在印刷循环期间能产生平稳均匀的滚动效果。通常在滚动的直径为 12 到 16mm (1/2 到 5/8 英寸)时即可开始。可以在一定的时间间隔向丝网上施加少量的新焊膏，以保持焊膏的化学和使用性能。丝网的清洗方式将随应用而变；不过，可采用 AIM DJAW 丝网清洗剂来完成。适中地使用 DJAW，从丝网上清除多余的清洁剂。

贴片信息

RMA201 可为当今的高速贴片设备提供足够的粘附时间和粘附力。提高产品的性能和可靠性。确保在组装和操作过程中对 PCB 板的适当支持可以提高产品性能和可靠性。

处理&储存

- ▶ RMA201 Au80-Sn20 在 4° C (40° F)温度下冷藏保存期为一年，在 22°C (70°F) 温度下，非冷藏保存期为 6 个月。不要冷冻该产品。
- ▶ 在打开密封使用焊膏之前，使焊膏充分且自然的升温至室温（建议放置 8 小时）。
- ▶ 轻而彻底的混合该产品 1-2 分钟，以保证任何分离的材料都能分布均匀。
- ▶ 请勿将新的和使用过的焊膏储存在同一容器中，不使用时请密封已打开的容器。
- ▶ 替换与 500 克罐子的盖子连在一起的内盖，以确保最佳的密封效果。

清洁

如需要，RMA201 可用加有皂化剂的自来水清洗，推荐使用 AIMTERGE 520，然而，建议用去离子水做最后漂洗。温度 212°C-302°C (100°F-150°F) 足以清洗掉任何残留。其他在线压力喷淋清洗宜可，但不是必需的。

安全

保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况，请参照 SDS 信息。不要在未核准容器内处理任何有害物质。